



电子元器件周报：晶圆代工产 值与资本开支同增长 半导体 行业景气度持续



晶圆代工产值与资本开支同增长，半导体行业景气度持续：目前全球芯片紧缺局面尚未缓解，晶圆代工产能呈现结构性紧张，半导体行业供需拐点尚未出现。受台积电等晶圆代工厂商的涨价影响，预计近两年晶圆代工产值将持续快速增长。根据 ICInsights 数据，2021 年全球晶圆代工厂总销售额增至 1072 亿美元，同比增长 23%，其中纯晶圆代工市场将达 871 亿美元，同比增长 24%。TrendForce 预估 2022 年晶圆代工产值将达 1176.9 亿美元，年增 13.3%。资本支出方面，目前台积电、联电等多家厂商大量投资新产能，TrendForce 预计 2021 年前十大晶圆代工业者资本支出超 500 亿美元，同比增长 43%，预估 2022 年资本支出将维持在 500~600 亿美元高档。

成熟制程缺货有望逐步缓解，部分制程短缺问题仍存：台积电、联电等多家厂商大量投资的新产能预计可在 2022 年下半年陆续开出，扩产制程主要为 40nm 及 28nm 为代表节点的成熟制程，因此 2022 年中成熟制程产能紧缺局面有望得到缓解。但另一方面，8 吋及 1Xnm 制程的紧缺预计仍难以缓解。8 吋晶圆方面，供给端看，由于扩产带来收益相对较低，产能增幅有限。需求端看，随着 5G 手机及电动车渗透率持续上升，8 吋晶圆需求增长，故预计 8 吋晶圆产能紧缺局面将持续。1Xnm 制程方面，因研发及扩产成本高昂，故目前仅有台积电、三星及格芯拥有该制程技术，而除格芯有计划小量扩产外，台积电、三星明年都没有明显扩产计划。但在 5G 手机渗透率持续提升的趋势下，对 1Xnm 制程的需求愈加高涨，此外，采用 1Xnm 制程 Wi-FiSoC 的部分智能手机以及 Wi-Fi router 需求也在不

断提升。预计 2022 年受 1Xnm 产能紧缺影响，相关零部件供货将受限。

投资建议：汽车电子领域关注国内 ODM 和功率半导体的龙头闻泰科技；半导体行业周期复苏，推荐封测板块长电科技、华天科技、通富微电；半导体材料板块沪硅产业、安集科技；半导体设备板块中微公司、汉钟精机、新莱应材；功率半导体厂商华润微；液晶面板板块相关公司京东方、TCL 科技；玻璃基板相关公司彩虹股份。超高清显示和背光双驱动，MiniLED 产业链持续发力，建议关注瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电、雷曼光电。

风险提示：疫情控制不及预期；下游需求不及预期；产能扩张不及预期；科技领域贸易摩擦加剧。

关键词: 5G LED 涨价 疫情 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29027

